尖點科技第三季營收創新高，獲利能力同步躍升

AI 高階需求強勁、產品組合持續優化，擴產布局加速推進

尖點科技 (8021) 董事會於今 (6) 日通過 2026 年第三季財務報告，並於下午召開法人說明會。受惠於全球 AI 伺服器高效能運算 (HPC) 及高速通訊市場需求持續成長，帶動高階 PCB 鑽孔加工需求提升，加上新產能逐步開出及高階產品比重增加，公司第三季營收創歷史新高，獲利能力亦同步提升，展現營運規模擴大與產品組合優化的雙重效益。

第三季合併營收達新台幣 23.31 億元，季增 27.65%、年增 99.44%，創單季歷史新高。單季營業毛利達 10.01 億元，毛利率提升至 42.95%，較去年同期 31.32%增加 11.63 個百分點，反映高階產品比重提升及規模經濟效益逐步顯現。單季營業費用為 3.06 億元，費用率降至 13.12%，帶動營業利益達 6.91 億元，季增 34.84%，年增 271.43%。歸屬於母公司業主淨利達 4.28 億元，占營收比重為為 18.36%，較去年同期 9.36%顯著成長，單季每股盈餘達新台幣 2.92 元。

累計 2026 年前三季合併營收達 54.96 億元，年增 79.11%，歸屬母公司業主淨利為 8.99 億元，年增 275.12%，累計每股盈餘達新台幣 6.18 元，整體營運維持強勁成長動能。

在產品組合方面，前三季高階鍍膜鑽針累計占比達 56%，提前超越原訂全年平均 55%的目標。隨著 AI 及高效能運算帶動 PCB 朝高層數、厚板及高階材料發展，對鑽針性能與加工精度的要求持續提升，進一步推升高附加價值產品需求。

為支應中長期成長及高階產能擴充需求，尖點科技已順利完成 2026 年度資本市場籌資計畫，包括第三次無擔保轉換公司債募集新台幣 6.52 億元，以及現金增資發行普通股 400 萬股、每股發行價格 388 元，募集新台幣 15.52 億元，**合計募集資金約 22.04 億元。**現金增資股款已於 10 月 30 日全數收足，新股並於今日正式上市。相關資金將主要用於擴充高階鍍膜鑽針產能，強化公司中長期成長動能。

展望未來，隨著 AI 伺服器、高效能運算及高速通訊需求持續成長，主要客戶積極擴充高階 PCB 產能，公司亦加速推進擴產計畫。鑽針月產能預計 2026 年底達 4,500 萬支，隨著台灣中壢及上海新廠陸續建置，規劃 2027 年底提升至 7,000 萬支，2028 年底進一步達 9,000 萬支，以支應中長期市場需求。

鑽孔服務方面，公司亦將配合客戶高階 PCB 產能擴充，持續擴大規模並提升高階板材加工能力。同時，持續投入高縱橫比鑽針、高性能鍍膜及精密加工技術，**進一步提升產品與服務的附加價值，帶動鑽針及鑽孔服務兩大業務持續成長。**

投資人關係聯絡資料
張家齊 Allen Chang
E-mail: ir@topoint.tw
Tel +886 2 2680 5868 Ext.868
Fax +886 2 2680 7588 Ext.868